

INVESTOR RELATIONS 2024

Innovative Manufacturing Technology

imt

imt
|주|아이엠티



DISCLAIMER

본 자료는 주식회사아이엠티(이하 "회사")와 관련하여 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시하는 Presentation에서의 정보제공을 목적으로 작성 되었으며
이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 자료의 열람은 위의 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을
유념해주시기 바랍니다. 또한, 본 자료의 활용으로 인해 발생하거나 발생할 수 있는 모든 손실에 대하여 '회사' 및 '회사'의 임직원과 주주, 자문역 및 기타
이해관계인들은 과실 및 기타의 모든 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 일체의 사항을 포함하는 것 (별도 '예측 정보'임을
표기하지 않았다 하더라도)으로 '회사' 및 산업의 향후 예상되는 변화 및 재무의 예상 실적을 의미하는 것입니다. 동 '예측정보'는 많은 변수에 따라 영향을 받으며,
본질적으로 불확실성을 가지고 있으므로 실제 미래에 나타나는 결과는 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

본 자료는 어떠한 주식의 매입 또는 매도 등 매매의 권유를 구성하지 아니하며, 본 자료의 그 어느 부분도 어떠한 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가
될 수 없습니다. 또한 본 자료는 어떠한 경우에도 민형사상의 분쟁 및 다툼에 있어서 증거자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

주식 매입 또는 매도 등 매매와 관련된 모든 투자 결정은 오직 금융감독원 전자공시시스템을 통해 제출한 신고서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 합니다.

INVESTOR RELATIONS 2024

TABLE OF CONTENTS

Chapter 1.

Company Overview

Chapter 2.

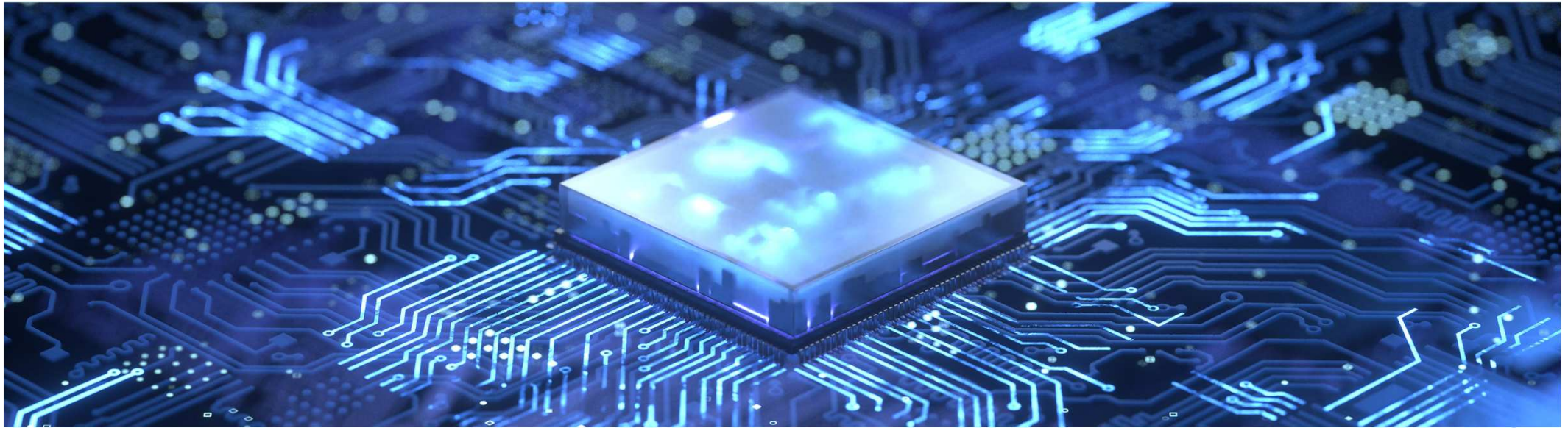
Core Technology

Chapter 3.

Business Strategy

Appendix

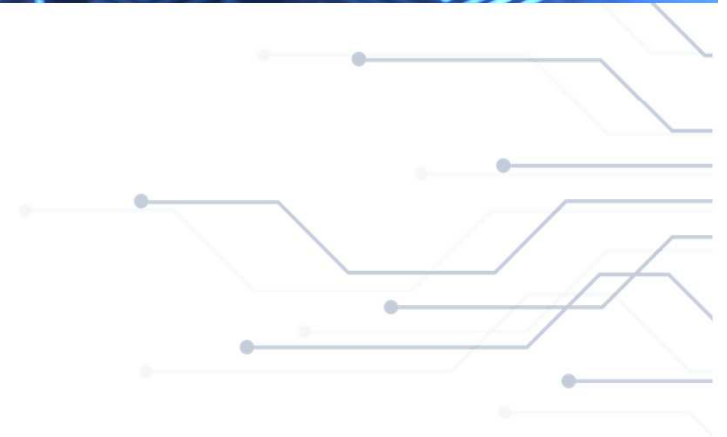
IMT



Chapter 1.

Company Overview

1. 회사개요
2. 성장연혁
3. IPO 개요 및 결과



20년 간 업력을 바탕으로 한 HBM, EUV 관련 공정장비 선도기업

회사 개요

회사명	주식회사 아이엠티
대표이사	최재성
주요제품	Laser & CO ₂ Cleaning 장비, EUV Mask Baking 장비
임직원수	46명(2024년 3월 말 기준)
자본금	39억 원
법인설립일	2000년 11월 23일
본사주소	경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층
홈페이지	www.imt-c.co.kr

해외 지사 및 법인



CEO Profile

- 現 아이엠티 대표이사
- 고등기술연구원
- 대우조선해양
- Univ. of Washington 재료공학 박사
- 서울대학교 금속공학과 학사



최재성 대표이사

주요 임원진



최종립 반도체 장비사업부 사장



이해광 부사장, CFO

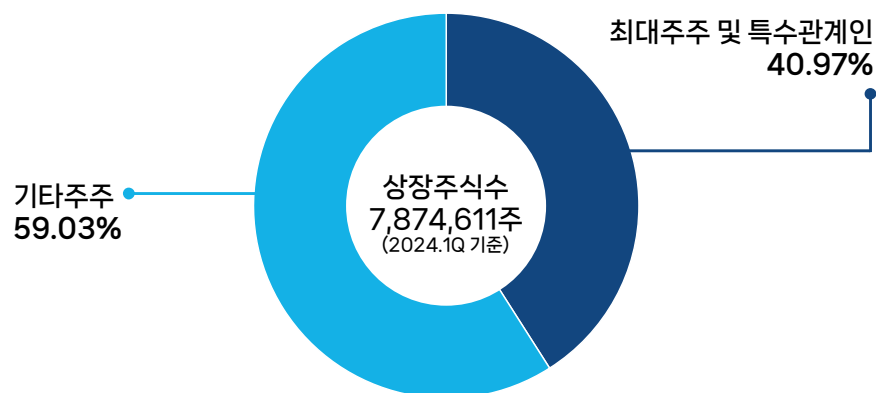
지속적인 기술개발을 통한 기술력 및 미래성장 동력 확보

설립기	2000~2007	성장기	2008~2019	도약기	2020~현재
• 회사 설립 및 기술투자 유치 • 주요 기술 인증	2000 (주)아이엠티 설립 2001 기술 연구소 설립(한국기술진흥협회) 2005 벤처기업 인증(경기지방중소기업청) 이노비즈 기업선정(경기지방중소기업청) 2006 ISO9001 품질경영 시스템 인증 _ IAF 2007 경기도 유망 중소기업(경기도청)	• 신규 기술 개발 및 고객사 확대 • 베트남 법인 설립	2013 수출유망중소기업(중소기업수출지원센터) 2015 Bar Type MicroJet Cleaning Nozzle 개발 및 공급 2016 EUV Laser Baking System 개발 및 공급 2018 1KW급 고출력 Laser Cleaning System 장비 개발 및 공급 2019 세계 최초 반도체 금형 In-Line Laser Cleaning 장비 개발 및 공급 EUV Mask Laser 복합시스템 개발 및 공급 IMT Vina 설립	• 본격 시장 진입 확대 • 해외 시장 네트워크 확장 및 신규 고객사 확대	2020 세계 최초 배터리(이차전지) Laser Cleaner 장비 개발 및 공급 소재 부품 장비 전문기업확인서 _한국산업 기술평가원 뿌리기업 확인서_한국생산기술연구원 ISO 14001 환경경영 시스템 인증 _ IAF ISO 45001 안전보건 경영시스템 인증 _ IAF 2021 세계 최초 공냉식 300W Laser Cleaning System 개발 2023 HBM용 Wafer CO₂ Cleaning 장비 개발 및 공급 지식개발경영인증_특허청 코스닥 상장

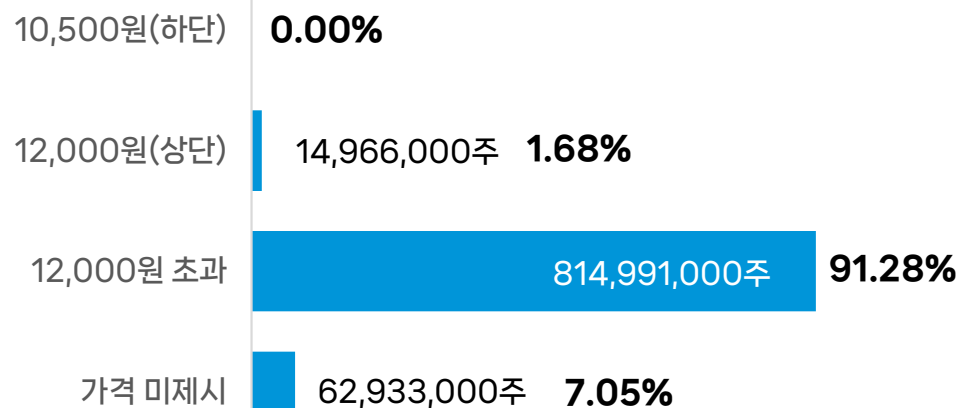
공모개요

공모주식수	1,580,000주
공모희망가액	10,500원 ~ 12,000원 → 확정공모가 14,000원
총공모금액	221.2억 원
상장주식수	7,874,611주
시가총액	1,102억 원
주관증권사	유안타증권(주)

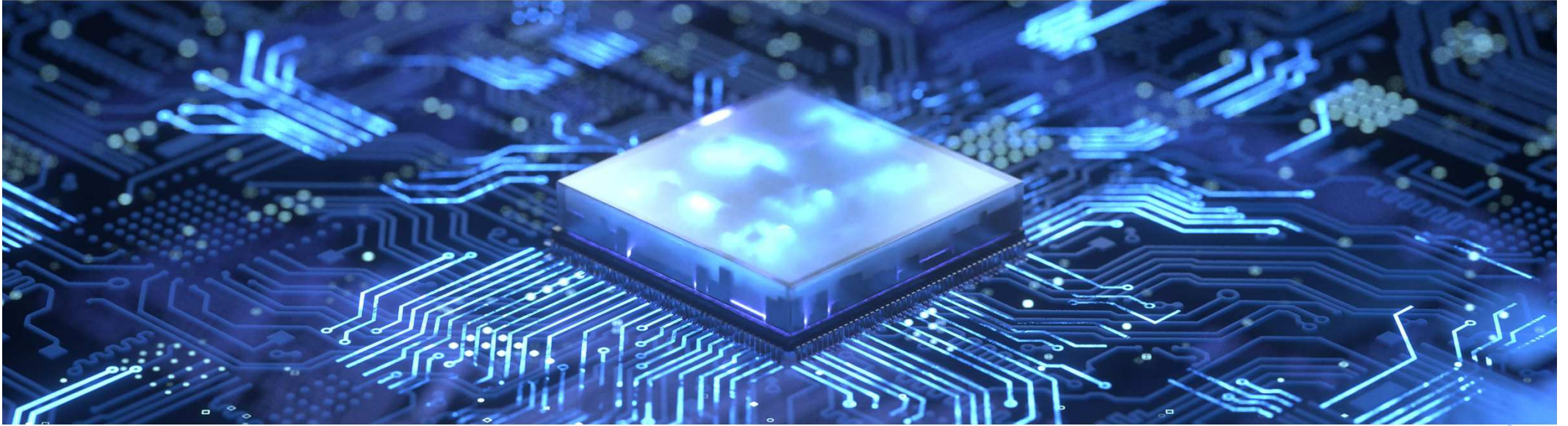
주주구성



수요예측결과



- **확정공모가 : 14,000원 (공모가밴드 상단초과)**
- 참여 기관투자자 : 1,821개 기관
- 신청수량 : 892,900,000주
- 수요예측 경쟁률 : 753.50 대1
- 청약 경쟁률 : 495.59 대 1



Chapter 2.

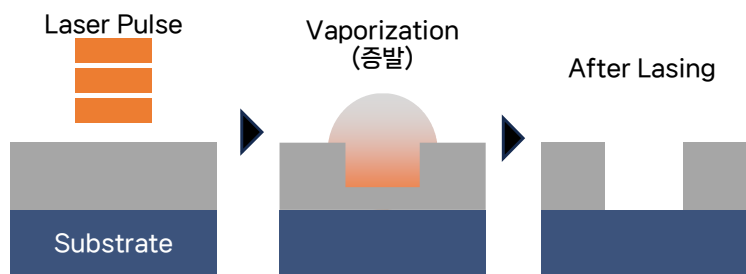
Core Technology

1. IMT 핵심기술
2. Laser Cleaning
3. CO₂ Cleaning

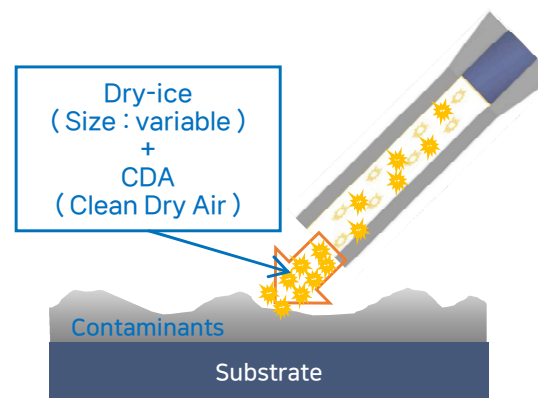


HBM 반도체용 건식세정 장비 관련 세계 최초 기술 보유

Laser 세정기술



CO₂ 세정기술



20년간 축적된
Know-How 및 풍부한 경험



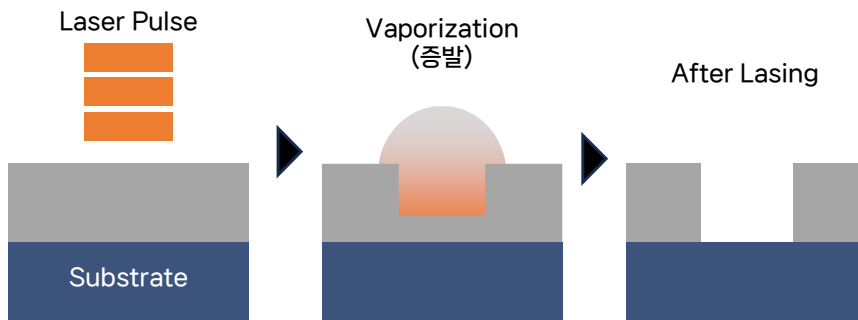
고유 모델의 세정전용 레이저 및
세계 최초의 CO₂ MicroJet 기술



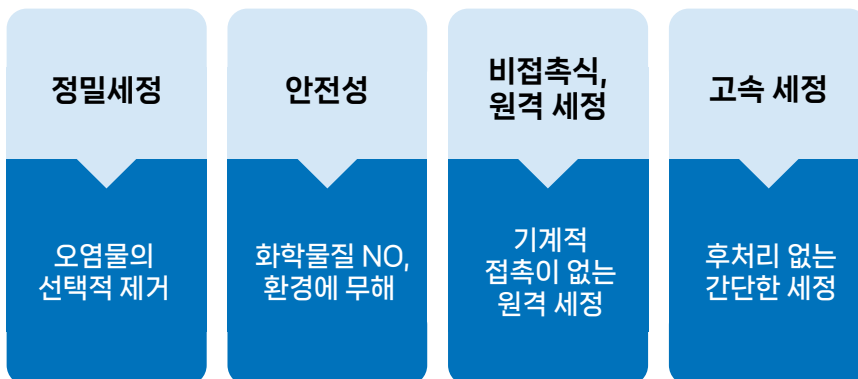
Top Tier 고객사들로 부터
검증된 기술

Laser Beam 에너지 Shaping 기술을 통한 Laser Cleaning 기술 고도화 성공

Laser Cleaning 기술의 원리 및 장점



Laser Cleaning의 장점



Laser Cleaning 사업영역

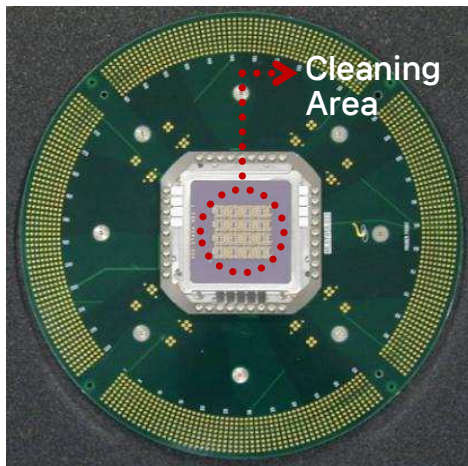


적용 확대

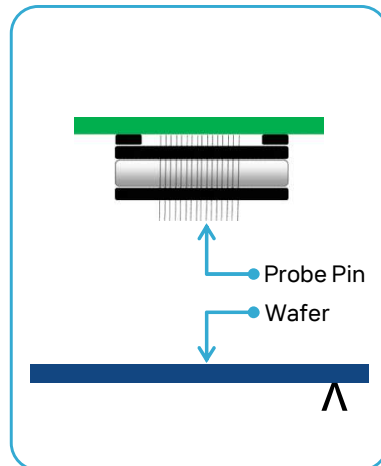


Laser Cleaning 기술의 고도화로 첨단 반도체 및 2차 전지 관련 사업영역 확장

Laser Probe Card Cleaner



- Probe Card Cleaning Area -



- Probe Pin 구조도 -

파우치형 2차 전지 Sealing Tool Cleaner



- Sealing Tool Cleaner 적용 현장 -



- CL 100 장비 -

- Pin과 Pin 사이의 간격(Pitch) 지속적 감소
- 고기능 Chip 개발로 Pin 숫자의 지속적 증대 (수천~수만개)
- Pin 단가의 지속적 상승

- 테스트 수율 향상
- Probe 카드 수명 증가

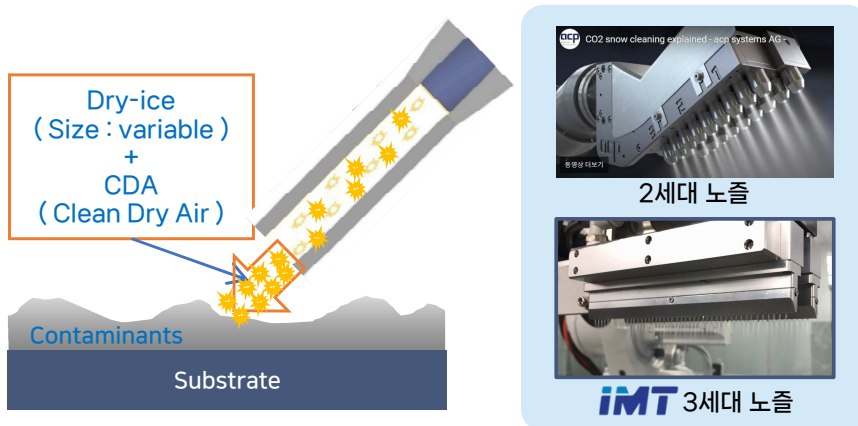
- 2차 전지 Sealing 공정 중 효율적인 오염물질 제거 필요
- L사와 공동 개발 완료

- 오염물질 효과적 제거로 배터리 안정성 향상
- 특허출원 완료
→ 독점적 사용 가능

기존 CO₂ Cleaning 기술의 한계를 극복하여 반도체 및 첨단 IT 산업에 적용 가능한 고유 기술 개발

CO₂ Cleaning 핵심 기술 및 Total Solution 확보 → Global Leading 기업 기술 도입 확대 中

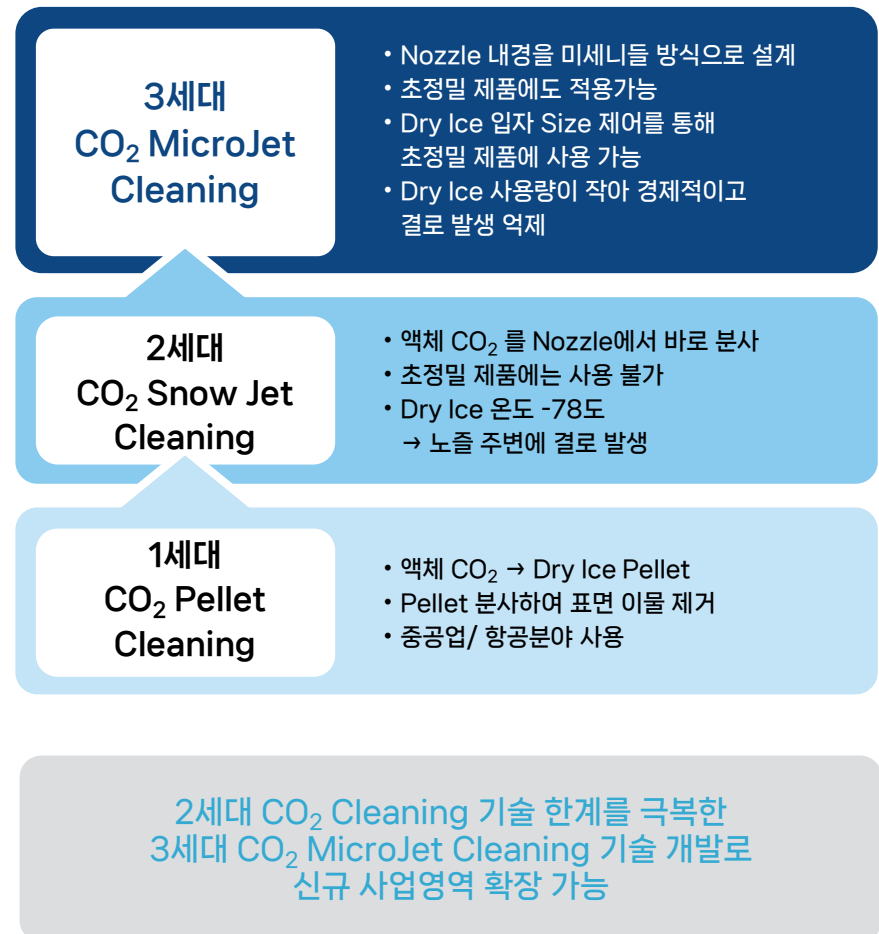
IMT MicroJet 기술의 원리 및 장점



IMT MicroJet 세정 기술의 강점



3세대 CO₂ Cleaning 기술 개발 성공

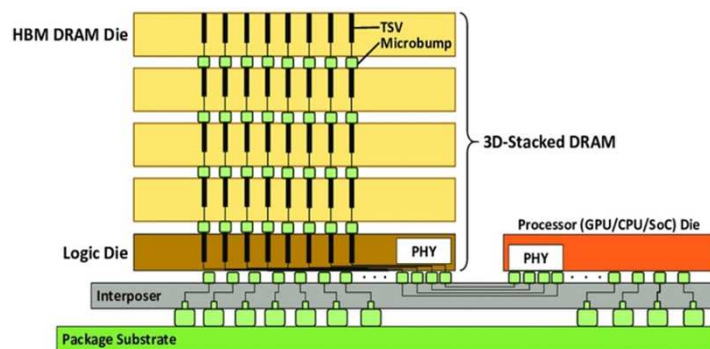


CO₂ Cleaning 기술의 HBM 진입 성공 → 일본 D사 대비 월등한 세정 성능(M사, H사 Test 통과)

HBM 기술과 주요 이슈

HBM이란?

단위 면적당 메모리 용량을 키우기 위한 수직으로 반도체를 적층하는 기술



- HBM 구조도 -

HBM 반도체 적층 공정 고도화 관련 주요 이슈

적층 상·하면 접점
불량 발생

적층 상·하면 사이
Particle 제거

HBM 공정에서
필수인 적층단계
Particle 세정 성공

건식 세정 기술

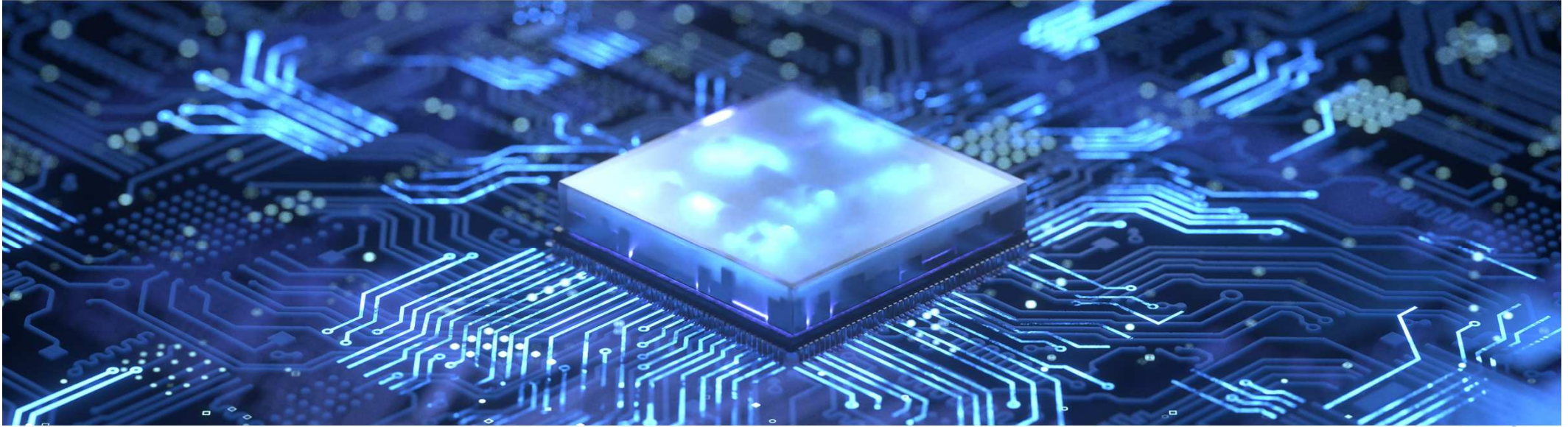
물이나 Chemical 없이 표면의 이물질 제거하는 기술
⇒ 물이나 Chemical을 사용할 수 없는 공정에서 활용

3대 주요 건식 세정 기술



"세계 유일 양대 건식 세정 기술 보유"

Laser Cleaning	CO ₂ Dry Ice Cleaning	Plasma Cleaning
Laser를 사용하여 이물질을 순간적으로 태워 없애는 기술	CO ₂ Dry Ice 입자를 분사하여 이물질을 제거하는 기술	Plasma를 이용하여 이물질 제거하는 기술 (세정보다는 표면 개질)
IMT P-Laser(벨기에) Clean Laser(독일)	IMT Cool Clean(미국) ACP(독일)	-



Chapter 3.

Business Strategy

1. Key Words
2. Background
3. Item (1) HBM용 Wafer CO₂ Cleaner
(2) HBM용 Substrate CO₂ Cleaner
(3) Laser Cleaner Probe Card_내장형
(4) Laser Cleaner for Packaging Mold
(5) HBM용 Carrier Wafer Reclaim
4. Summary

Key Word → IMT Inside !

반도체의 기술 발전: Ultra Fine Patterning & Multi Stacking

1

건식 세정 기술의 Needs가 커지고 있음

2

세계 1위 장비 업체들과 협업하여 건식 세정 장비를 내장

3

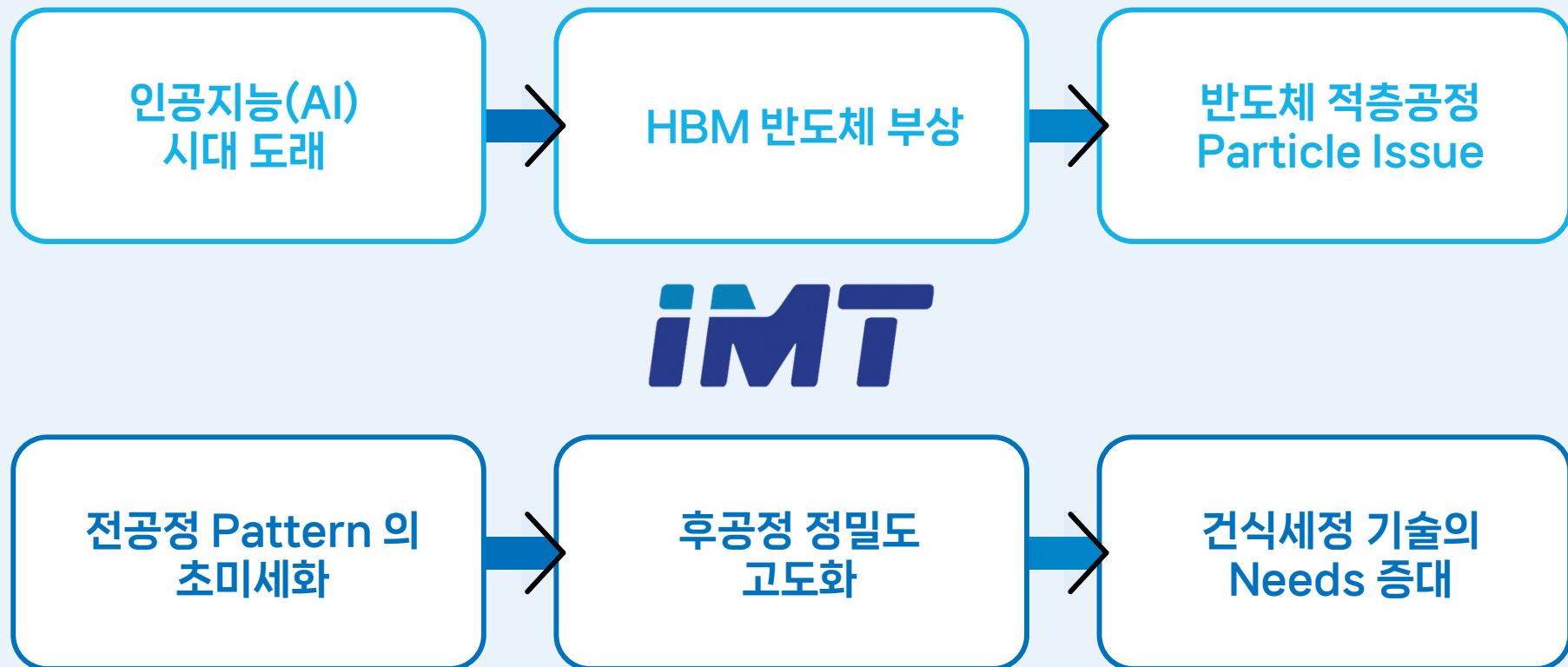
Driving Force: 장비사용업체 (chip maker)가 요구하도록 유도

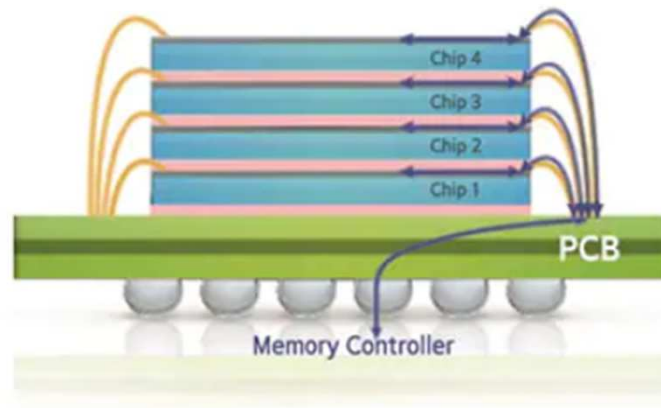
4

CO₂, Laser 세정 Two Track으로 진행

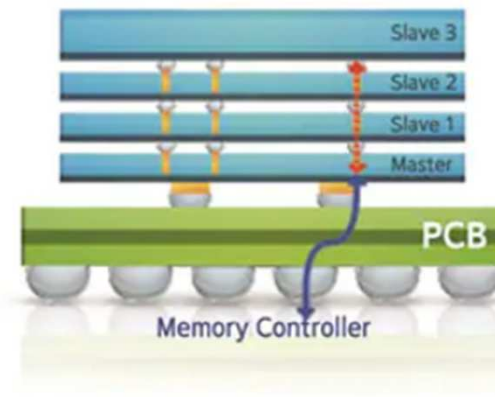
5

인공지능(AI)시대로 인한 HBM 반도체 부상 → 건식세정 요구





Wire Bonding Technology



TSV Technology

Alignment Issue

+

Particle Issue

두께 (Ultra Thin)

720um
(HBM2, HBM3)775um
(HBM4)

관통전극수(TSV)

1024개
(HBM2, HBM3)2048개
(HBM4)

HBM 2, HBM3의 경우 Chip 1개당 1024개 관통전극



1. 지속적 Gap 축소
2. Solder Ball 제거
3. Hybrid Bonding 기술 요구

허용 Particle Size 축소
(10um → 5um → 3um → 1um)

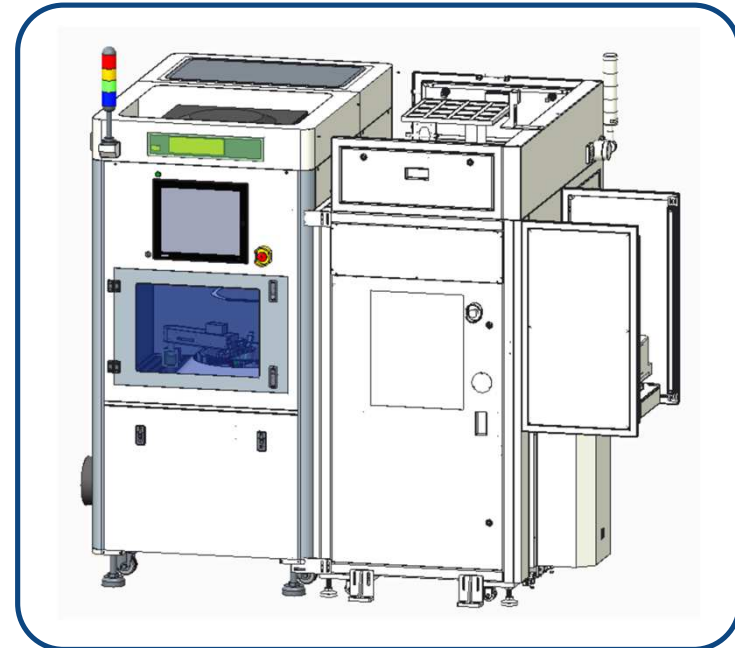
습식세정 대신
건식세정 요구
(Cu Oxidation 방지)

Item_(1)HBM용 Wafer CO₂ Cleaner

2 Chamber



1 Chamber



1세대

Particle Size

고객사

1호기

10um

2호기

5um

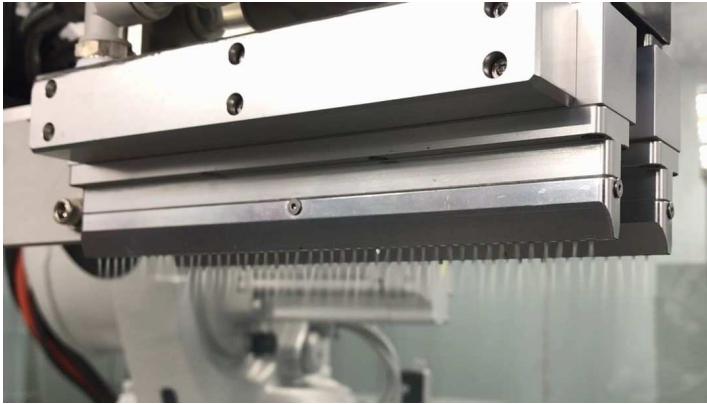
3호기

3um

M사
HBM2
HBM3

2세대

Particle Size: 1um
Target : HBM4 (HBM 3사 공통)

IMT CO₂ 세정 장비

+



국내 D사 Mold 공정 검사 장비

H사 공정 적용



TEL Prober
(Precio XL Model)

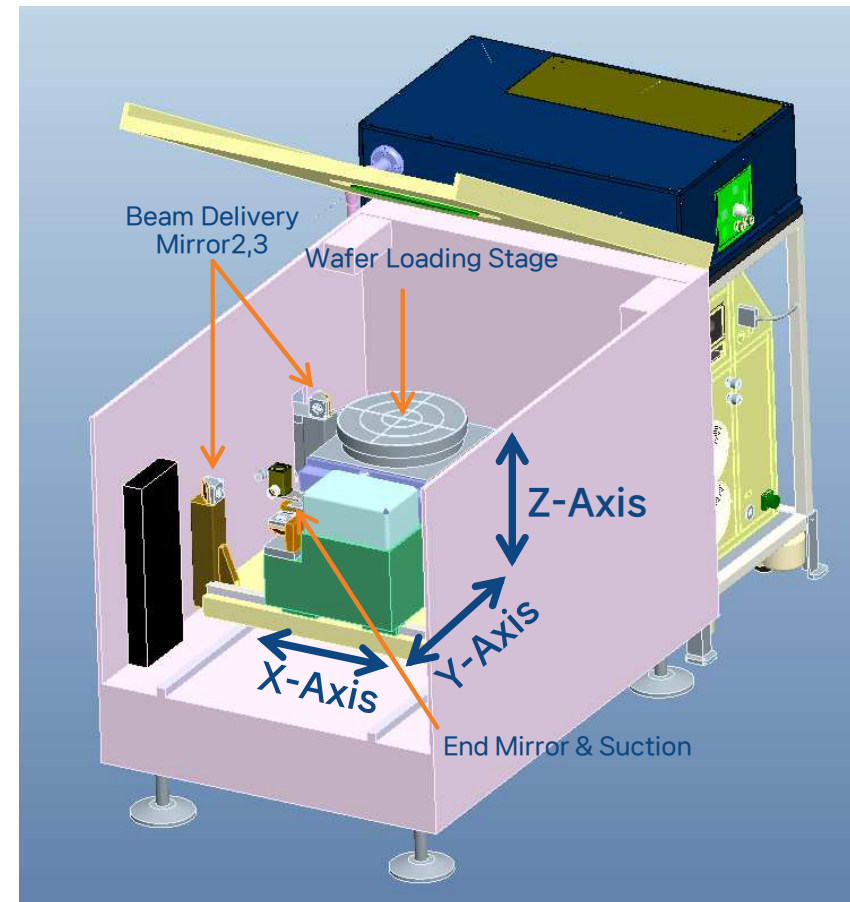
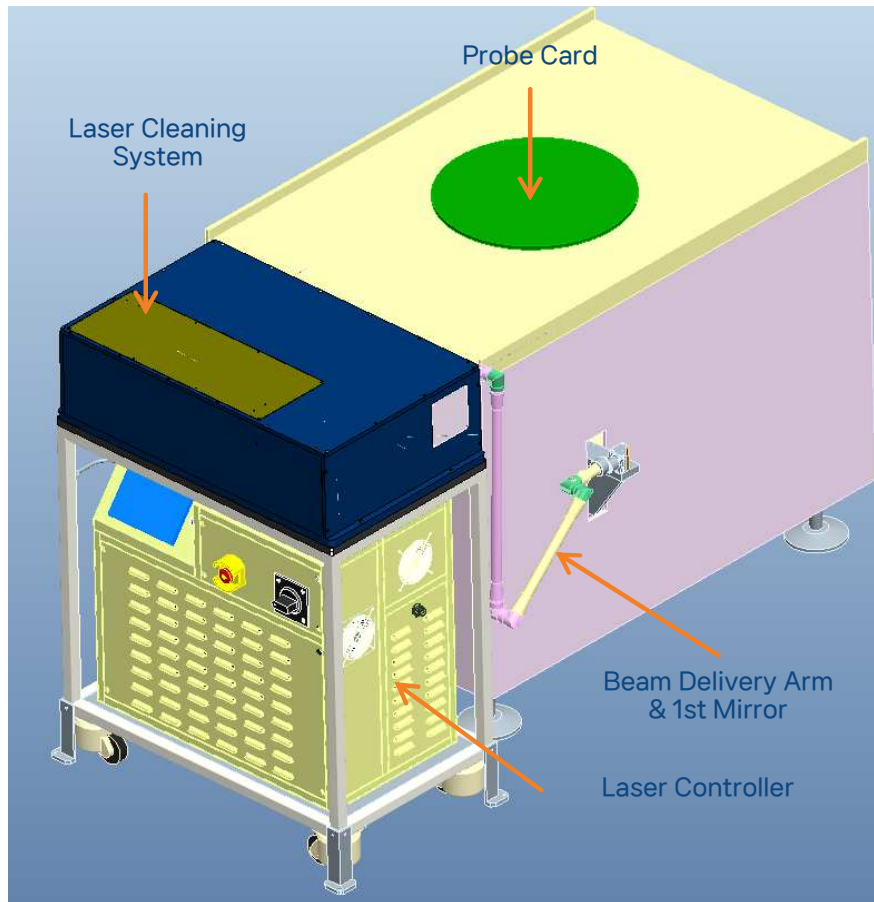
Integrate



IMT Laser Cleaner
(PLI-3000 Model)

MEMS Probe Card 세정에 탁월한 효과

내장형 개념도



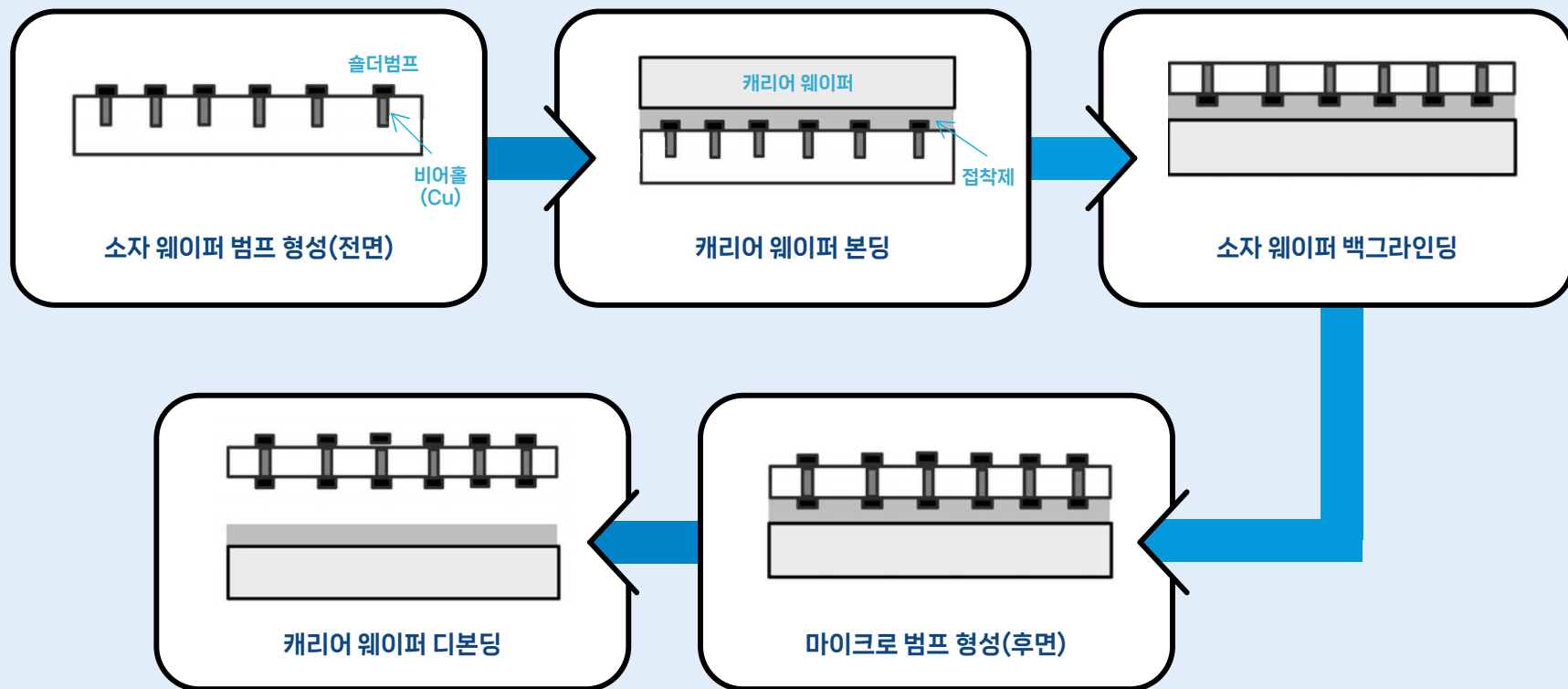
Item_(4) Laser Cleaner for Packaging Mold



IMT
Laser Cleaner



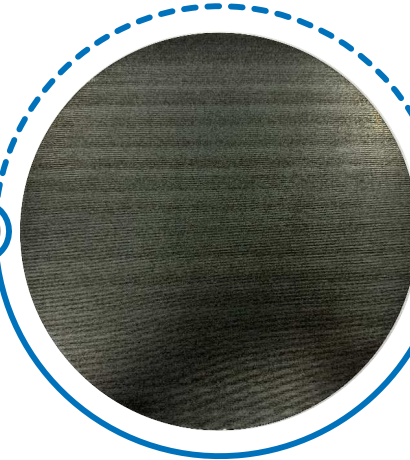
Laser Cleaner Components
for Mold Press Integration



Before Cleaning



After Laser Cleaning

After CO₂ Cleaning

After Final Treatment



신규 사업 개발
: 전용장비 개발 완료

Vision of *IMT*

→ "*IMT* Inside"

2가지 독점 핵심 기술

1. Laser Cleaning

2. CO₂ Microjet™

Stealth Dicing 장비와 결합

→ Post Dicing Wafer CO₂ Cleaner (M사)

AOI 장비와 결합

→ Mold 공정 용 CO₂ Cleaner (H사)

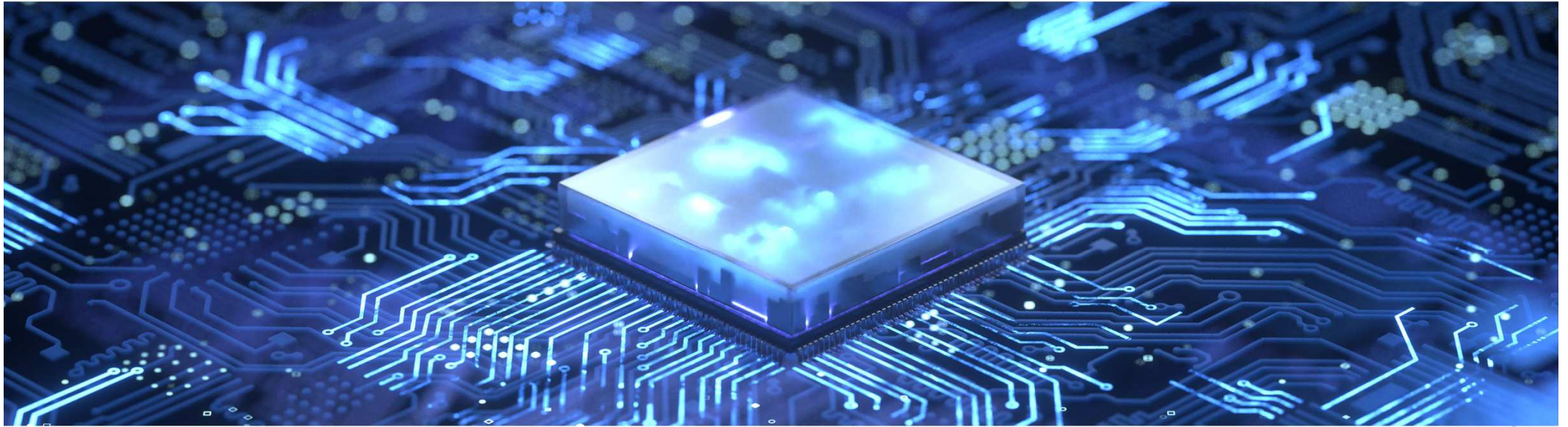
Prober 장비와 결합

→ In-line Probe Card Laser Cleaner (T사, K사)

Mold Press 장비와 결합

→ In-line Mold Laser Cleaner (A사)

Carrier Wafer Reclaim 사업 (H사)



Appendix

1. 요약 재무제표(연결)



연결 재무상태표

단위: 백만 원

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년 1Q
유동자산	9,248	8,433	24,521	24,507
비유동자산	6,726	6,568	5,755	6,245
자산총계	15,974	15,002	30,275	30,752
유동부채	10,137	4,283	1,038	1,517
비유동부채	2,849	3,141	2,682	3,148
부채총계	12,987	7,425	3,720	4,665
자본금	2,380	2,380	3,937	3,937
자본잉여금	1,570	5,640	26,348	11,348
자본조정	-	-	-	-
기타포괄손익누계액	-12	-39	-31	-102
이익잉여금	-950	-1,146	-3,698	10,904
자본총계	2,987	7,577	26,556	26,086

연결 손익계산서

단위: 백만 원

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년 1Q
매출액	7,327	10,756	6,470	1,727
매출원가	4,716	6,693	4,210	1,190
매출총이익	2,610	4,063	2,260	537
판매비와관리비	3,199	3,809	4,499	1,202
영업이익	-588	254	-2,239	-665
영업외수익	1,227	981	614	337
영업외비용	1,252	2,213	325	70
법인세차감전순이익	-614	-978	-1,949	-399
법인세비용	-44	-548	378	-
당기순이익	-569	-429	-2,327	-399

INVESTOR
RELATIONS
2024

Q&A